



RE460

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 µm Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Superficie Ni/Au chimico, rivestita con maschera di saldatura
- Distanze del reticolo da 0,50 mm a 1,27 mm
- Diametro del foro 1,00 mm
- Circuito di adattamento per 23 diversi SMD-IC
- Punti di rottura predeterminati per separare i singoli moduli del circuito
- Saldatura manuale: per l'elaborazione individuale SMD nell'area di laboratorio è possibile un incarico a mano libera da 100 a 200 punti individuali con dispositivi di dosaggio precisi in reticoli di dimensioni da 0,50 mm a 1,27 mm
- Saldatura reflow grazie ad apposite sagome SMD prodotte separatamente
- Dimensioni 120 x 175 mm

N. modulo	pitch	pin
RE460-01	0,800 mm	QFP 32, 80
	0,500 mm	QFP 64
RE460-02	0,800 mm	QFP 80
	0,650 mm	QFP 100
RE460-03	0,650 mm	QFP 80, 84
RE460-04	0,650 mm	QFP 144, 160
	0,635 mm	QFP 100, 132, 164
RE460-05	1,270 mm	PLCC 32, 52, 68, 84
	0,635 mm	QFP 100
	0,500 mm	QFP 100
RE460-06	1,270 mm	PLCC 28, 44
	0,800 mm	QFP 44
RE460-07	1,270 mm	PLCC 18
RE460-08	1,270 mm	PLCC 20
RE460-09	1,270 mm	PLCC-Eprom 32